



## 武汉精测电子集团股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称及人员姓名	西部证券段倩、张艺杰；申万宏源刘建伟、何传霖；中信证券程子盈；华源证券王慧文、赵帆、刘俊；长江证券童松、孟星、王伟；嘉实基金刘晔、彭民、孟夏、孟丽婷、蔡丞丰、黄福大、左勇；易方达苏海鸿；华宝基金李薇依；华商基金康译丹；摩根基金宋敬祎；平安基金何杰；浙商资管覃思远；华泰资管余熠；运舟资本周应波、丁俊枫；上海证券张胡学；泰康资管商熠峰；红土创新郑伟佳；国寿安保熊靓；万泰华瑞罗帆；重阳投资张驰；恒生前海基金刘雅琪；冲积资管褚壹钦、王泉涌；上海从容资管赖俊文；磐泽资管施巧瑜；姚泾河投资李凡；前海博普资管雍国铁；上海新传奇陈天友等 41 余人（排名不分先后）
时间	2026 年 1 月 21 日-2026 年 1 月 23 日
地点	武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路 2 号公司会议室
上市公司接待人 员姓名	副总经理、董事会秘书：刘炳华先生 证券事务代表：程敏女士
投资者关系活动 主要内容介绍	<b>Q1：公司半导体量检测领域发展现状如何？</b> A：公司紧抓半导体设备国产化替代的关键窗口期，持续巩固并提升在半导体量检测领域的国内领先地位，积极向产业链上游核心环节延伸，强化关键部件自主可控能力，同时进一步加大了对先进制程领域的研发投入和产品布局，截至《2025 年第三季度报告》披露日，公司半导体领域营收 26,712.22 万元，较上



年同期增长 48.67%，归母净利润 2,103 万元。公司膜厚系列产品、OCD 设备、电子束设备、半导体硅片应力测量设备、明场光学缺陷检测设备等核心产品均处于国内行业领先地位，竞争优势明显。

半导体前道量测领域膜厚系列产品、OCD 设备、电子束设备等部分主力产品已完成 7nm 先进制程的交付及验收，目前更加先进制程的产品正在验证中。先进制程产品占公司整体营收和订单的比例不断增加，现已成为公司业绩的核心驱动力。半导体领域目前已成为公司业绩核心，公司对整个半导体领域行业以及公司在该领域持续快速增长充满信心。公司已于 2025 年 12 月 10 日、2025 年 12 月 31 日相继披露了《关于签订日常经营性重大合同的公告》（公告编号：2025-150、公告编号：2025-162），具体内容详见相关公告。

#### **Q2：公司显示检测领域发展现状如何？**

A：2025 年，平板显示行业正逐渐走出周期性底部，LCD 大尺寸、超大尺寸预计仍存在扩线投资需求；OLED 技术日趋成熟，应用场景和销售占比逐步增加，随着消费领域头部客户 IT 类产品逐步使用 OLED 屏幕带来的行业风向标，以及国内龙头企业京东方 G8.60LED 项目的投建，中大尺寸 OLED 的新建投资预计会持续进行。公司牢牢把握显示产业上述市场机遇，继续保持在显示领域的高研发投入，2025 年第三季度，公司在显示板块实现销售收入 56,474.58 万元，较上年同期增长 14.67%；归母净利润 12,147 万元。

#### **Q3：公司子公司武汉精鸿发展情况如何？**

A：公司子公司武汉精鸿现阶段主要聚焦自动测试设备(ATE)领域(主要产品是存储芯片测试设备)，核心产品覆盖半导体后道电学测量制程，从 CP 晶圆探测到 BI 老化测试，再到 FT 最终测试，能为芯片设计/制造/封测企业及 IDM 厂商提供全流程定制化的芯片测试设备及解决方案。2025 年 11 月，公司向武汉精鸿增



资 4,000 万元，公司员工向武汉精鸿增资 1,000 万元，此次增资扩股事项有利于武汉精鸿在获得充裕资金得以开展半导体检测设备的研发和生产业务的同时，实现核心团队与公司发展的深度绑定，对武汉精鸿未来的发展具有重要意义。

**Q4：公司在先进封装领域的进展情况如何？**

A：公司积极对先进封装技术进行战略布局，通过增资持有湖北星辰技术有限公司（以下简称“湖北星辰”）33.6414%的股权，深化了与湖北星辰等核心客户的战略合作与绑定。现阶段，湖北星辰已建成国内领先的 12 英寸集成电路先进封装研发线，核心工艺已全面贯通，可为客户提供一站式先进封装成套解决方案。目前，已进入客户导入阶段。同时，根据市场需求，正在部署建设研发线二期项目。公司在半导体行业的布局从前道量测设备拓展至半导体制造封装产业链，有利于公司抓住数据中心、超算、AI 产业快速发展的历史机遇，同时促进公司半导体业务的增长，对公司的长远发展具有重要意义。

**Q5：请介绍公司控股子公司上海精测购买土地使用权的情况。**

A：为加快向更先进制程工艺的迭代升级，提升综合研发能力和竞争实力，进一步落实未来发展战略规划，公司控股子公司上海精测拟购买位于上海市青浦区市西软件信息园 F2-05 地块的土地使用权，并投资建设上海精测半导体技术有限公司二期实验室扩建项目。本项目计划总投资约人民币 3.5 亿元。

本次上海精测拟购买土地使用权，用于投资建设上海精测半导体技术有限公司二期实验室扩建项目，以满足公司实际业务发展和实际经营的需要。通过本次项目建设，公司将进一步完善公司产品结构，提前预留工艺开发与产能扩张空间，为未来业务规模提升和新产品持续导入奠定基础，并有效缓解现有产线资源紧张状况，加快订单交付节奏，更好满足客户批量供货需求，进一步巩固公司的核心竞争力。此次投资符合公司整体战略规划和长



## 精测电子投资者关系活动记录表（2026 年度）

	<p>期发展需要，对公司未来发展及综合竞争力的提升具有积极推动作用。</p> <p>接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 1 月 23 日